

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于参加科创板 2026 年半年度半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 9 月 3 日（星期四）至 9 月 9 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@nexchip.com.cn）进行提问。合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）将在业绩说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2026 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00 参加科创板 2026 年半年度半导体制造、设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- (一) 会议召开时间：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00
- (二) 会议召开地点：上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- (三) 会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长：蔡国智

董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理：朱才伟

独立董事：安广实

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 9 月 3 日（星期四）至 9 月 9 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@nexchip.com.cn）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0551-62637000 转 612688

邮箱：stock@nexchip.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日